



2022年8月30日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢  
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)  
問 合 わ せ 先 I R 室 長 野 田 耕 一  
( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

### 半導体ウエーハ持分法適用関連会社による上海証券取引所科创板市場への上場申請に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、当社持分法適用関連会社である杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下、「CCMC」）が、2022年8月18日に上海証券取引所科创板市場（以下、「科创板」）へ上場申請書を提出し、2022年8月29日に申請受理を確認したので、以下の通りお知らせします。

なお、本件申請については、本日時点において科创板による上場承認がなされたものではなく、また今後の上場承認を保証するものではありません。また、CCMCは科创板による上場承認が得られた場合でも、株式市況ならびに事業環境の変化等を理由として上場申請を取りやめる場合がありますことをご留意ください。

#### 記

#### 1. 上場申請会社の概要（2022年6月30日現在）

|     |                 |  |                     |
|-----|-----------------|--|---------------------|
| (1) | 名 称             | 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（CCMC）                    |                     |
| (2) | 所 在 地           | 中国浙江省杭州市钱塘新区東壘路 888 号                    |                     |
| (3) | 代表者の役職・氏名       | 董事長 賀 賢漢                                 |                     |
| (4) | 事 業 内 容         | 半導体ウエーハの製造・販売                            |                     |
| (5) | 資 本 金           | 5,032 百万人民币元（約 1,008 億円） ※ 1 中国元=20.03 円 |                     |
| (6) | 設 立 年 月 日       | 2017 年 9 月 28 日                          |                     |
| (7) | 当 社 出 資 比 率     | 23.05%                                   |                     |
| (8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資 本 関 係                                  | 当該会社は当社の持分法適用関連会社です |
|     |                 | 人 的 関 係                                  | 当社の取締役 1 名が同社の董事を兼任 |
|     |                 | 取 引 関 係                                  | 該当事項はありません          |

#### 2. 今後の見通し

当社の今期連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。なお、CCMCが申請通りに上場した場合の当社連結業績に与える影響は、科创板における CCMC 株式の価格設定、上場株式数、上場後の希薄化の程度等様々な要因に左右されるため、本件申請が当社連結業績に与える影響については、現時点では未定です。

以 上